

# 2024-2030年中国半导体材料行业前景展望与发展趋势研究报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2024-2030年中国半导体材料行业前景展望与发展趋势研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202407/464319.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2024-2030年中国半导体材料行业前景展望与发展趋势研究报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

### 第1章：半导体材料行业概念界定及发展环境剖析

#### 1.1 半导体材料的概念界定及统计口径说明

##### 1.1.1 半导体材料概念界定

##### 1.1.2 半导体材料的分类

###### （1）前端制造材料

###### （2）后端封装材料

##### 1.1.3 行业所属的国民经济分类

##### 1.1.4 本报告的数据来源及统计标准说明

#### 1.2 半导体材料行业政策环境分析

##### 1.2.1 行业监管体系及机构

##### 1.2.2 行业规范标准

##### 1.2.3 行业发展相关政策汇总及重点政策解读

###### （1）行业发展相关政策汇总

###### （2）行业发展重点政策解读

##### 1.2.4 行业相关规划汇总及解读

###### （1）国家层面

###### （2）地方层面

##### 1.2.5 政策环境对行业发展的影响分析

#### 1.3 半导体材料行业经济环境分析

##### 1.3.1 宏观经济现状

###### （1）GDP发展分析

###### （2）固定资产投资分析

###### （3）工业经济运行分析

### 1.3.2 经济转型升级发展分析（智能制造）

### 1.3.3 宏观经济展望

#### （1）GDP增速预测

#### （2）行业综合展望

### 1.3.4 经济环境对行业发展的影响分析

## 1.4 半导体材料行业投资环境分析

### 1.4.1 国家集成电路产业投资基金

#### （1）大基金一期

#### （2）大基金二期

### 1.4.2 半导体材料行业投资、兼并与重组分析

#### （1）行业投资、兼并与重组发展现状分析

#### （2）行业投资、兼并与重组发展事件汇总

### 1.4.3 投资环境对行业发展的影响分析

## 1.5 半导体材料行业技术环境分析

### 1.5.1 半导体行业技术迭代

### 1.5.2 相关专利的申请情况分析

#### （1）硅片

#### （2）电子特气

#### （3）光刻胶

### 1.5.3 美国对中国半导体行业的相关制裁事件

### 1.5.4 半导体材料行业技术发展趋势

### 1.5.5 技术环境对行业发展的影响分析

## 第2章：全球及中国半导体行业发展及半导体材料所处位置

### 2.1 半导体产业迁移历程分析

#### 2.1.1 全球半导体产业迁移路径总览

#### 2.1.2 阶段一：从美国向日本迁移

#### 2.1.3 阶段二：向韩国、中国台湾迁移

#### 2.1.4 阶段三：向中国大陆地区转移

#### 2.1.5 全球半导体产业发展总结分析

### 2.2 全球半导体行业发展现状分析

#### 2.2.1 全球半导体行业市场规模

- 2.2.2 全球半导体行业结构竞争格局
- 2.2.3 全球半导体行业产品竞争格局
- 2.2.4 全球半导体行业区域竞争格局
- 2.3 中国半导体行业发展现状分析
  - 2.3.1 中国半导体行业市场规模
  - 2.3.2 中国半导体行业结构竞争格局
    - (1) 中国半导体行业结构竞争格局
    - (2) 半导体设计环节规模
    - (3) 半导体制造环节规模
    - (4) 半导体封装测试环节规模
  - 2.3.3 中国半导体行业区域竞争格局
- 2.4 半导体材料与半导体行业的关联
  - 2.4.1 半导体材料在半导体产业链中的位置
  - 2.4.2 半导体材料对半导体行业发展的影响分析
- 2.5 全球及中国半导体行业发展前景及趋势分析
  - 2.5.1 半导体行业发展前景分析
    - (1) 全球半导体行业发展前景分析
    - (2) 中国半导体行业发展前景分析
  - 2.5.2 半导体行业发展趋势分析

### 第3章：全球半导体材料行业发展现状及前景分析

- 3.1 全球半导体材料行业发展现状分析
  - 3.1.1 全球半导体材料行业发展历程
  - 3.1.2 全球半导体材料行业市场规模
  - 3.1.3 全球半导体材料行业竞争格局
    - (1) 区域竞争格局
    - (2) 产品竞争格局
    - (3) 企业/品牌竞争格局
- 3.2 全球主要国家/地区半导体材料行业发展现状分析
  - 3.2.1 中国台湾地区半导体材料行业发展分析
    - (1) 半导体材料行业发展特点
    - (2) 半导体材料行业市场规模

(3) 半导体材料行业在全球的地位

### 3.2.2 韩国半导体材料行业发展分析

(1) 半导体材料行业发展特点

(2) 半导体材料行业市场规模

(3) 半导体材料行业在全球的地位

### 3.2.3 日本半导体材料行业发展分析

(1) 半导体材料行业发展特点

(2) 半导体材料行业市场规模

(3) 半导体材料行业在全球的地位

### 3.2.4 北美半导体材料行业发展分析

(1) 半导体材料行业发展特点

(2) 半导体材料行业市场规模

(3) 半导体材料行业在全球的地位

## 3.3 全球半导体材料代表企业案例分析

### 3.3.1 日本揖斐电株式会社 (IBIDEN)

(1) 企业基本情况

(2) 企业经营情况

(3) 企业半导体材料业务布局

(4) 企业在华投资布局情况

### 3.3.2 日本信越化学工业株式会社

(1) 企业基本情况

(2) 企业经营情况

(3) 企业半导体材料业务布局

(4) 企业在华投资布局情况

### 3.3.3 日本株式会社SUMCO

(1) 企业基本情况

(2) 企业经营情况

(3) 企业半导体材料业务布局

(4) 企业在华投资布局情况

### 3.3.4 空气化工产品有限公司

(1) 企业基本情况

(2) 企业经营情况

(3) 企业半导体材料业务布局

(4) 企业在华投资布局情况

### 3.3.5 林德集团

(1) 企业基本情况

(2) 企业经营情况

(3) 企业半导体材料业务布局

(4) 企业在华投资布局情况

### 3.4 全球半导体材料行业发展前景及趋势

#### 3.4.1 全球半导体材料行业发展前景分析

#### 3.4.2 全球半导体材料行业发展趋势分析

## 第4章：中国半导体材料行业发展现状分析

### 4.1 中国半导体材料行业发展概述

#### 4.1.1 行业发展历程分析

#### 4.1.2 中国半导体材料行业市场规模分析

#### 4.1.3 中国半导体材料行业在全球的地位分析

#### 4.1.4 中国半导体材料行业企业竞争格局

### 4.2 中国半导体材料行业进出口分析

#### 4.2.1 中国半导体材料行业进出口市场分析

#### 4.2.2 中国半导体材料行业进口分析

(1) 行业进口总体分析

(2) 行业进口主要产品分析

#### 4.2.3 中国半导体材料行业出口分析

(1) 行业出口总体分析

(2) 行业出口主要产品分析

### 4.3 中国半导体材料行业波特五力模型分析

#### 4.3.1 现有竞争者之间的竞争

#### 4.3.2 对关键要素的供应商议价能力分析

#### 4.3.3 对消费者议价能力分析

#### 4.3.4 行业潜在进入者分析

#### 4.3.5 替代品风险分析

#### 4.3.6 竞争情况总结

#### 4.4 中国半导体材料行业发展痛点分析

##### 4.4.1 前端晶圆制造材料核心优势不足

##### 4.4.2 半导体材料对外依存度大

##### 4.4.3 半导体材料国产化不足

### 第5章：中国半导体材料行业细分市场分析

#### 5.1 中国半导体材料工艺及细分市场构成分析

##### 5.1.1 半导体制造工艺

##### 5.1.2 中国半导体材料行业细分市场格局

(1) 中国半导体材料行业细分市场竞争格局

(2) 中国晶圆制造材料细分产品规模情况

(3) 中国封装材料细分产品规模情况

#### 5.2 中国半导体材料（前端晶圆制造材料）发展现状及趋势分析

##### 5.2.1 中国半导体硅片发展现状及趋势分析

(1) 半导体硅片工艺概述

(2) 半导体硅片技术发展分析

(3) 半导体硅片发展现状分析

(4) 半导体硅片竞争格局

(5) 半导体硅片国产化现状

(6) 半导体硅片发展趋势分析

##### 5.2.2 中国电子特气发展现状及趋势分析

(1) 电子特气工艺概述

(2) 电子特气技术发展分析

(3) 电子特气发展现状分析

(4) 电子特气竞争格局

(5) 电子特气国产化现状

(6) 电子特气发展趋势分析

##### 5.2.3 中国光掩膜版发展现状及趋势分析

(1) 光掩膜版工艺概述

(2) 光掩膜版技术发展分析

(3) 光掩膜版发展现状分析

(4) 光掩膜版竞争格局

(5) 光掩膜版国产化现状

(6) 光掩膜版发展趋势分析

#### 5.2.4 中国光刻胶及配套材料发展现状及趋势分析

(1) 光刻胶及配套材料工艺概述

(2) 光刻胶及配套材料技术发展分析

(3) 光刻胶及配套材料发展现状分析

(4) 光刻胶及配套材料竞争格局

(5) 光刻胶及配套材料国产化现状

(6) 光刻胶及配套材料发展趋势分析

#### 5.2.5 中国抛光材料发展现状及趋势分析

(1) 抛光材料工艺概述

(2) 抛光材料技术发展分析

(3) 抛光材料发展现状分析

(4) 抛光材料竞争格局

(5) 抛光材料国产化现状

(6) 抛光材料发展趋势分析

#### 5.2.6 中国湿电子化学品发展现状及趋势分析

(1) 湿电子化学品工艺概述

(2) 湿电子化学品技术发展分析

(3) 湿电子化学品发展现状分析

(4) 湿电子化学品竞争格局

(5) 湿电子化学品国产化现状

(6) 湿电子化学品发展趋势分析

#### 5.2.7 中国靶材发展现状及趋势分析

(1) 靶材工艺概述

(2) 靶材技术发展分析

(3) 靶材发展现状分析

(4) 靶材竞争格局

(5) 靶材国产化现状

(6) 靶材发展趋势分析

### 5.3 中国半导体材料（后端封装材料）发展现状及趋势分析

#### 5.3.1 中国封装基板发展现状及趋势分析

- (1) 封装基板工艺概述
- (2) 封装基板技术发展分析
- (3) 封装基板发展现状分析
- (4) 封装基板竞争格局
- (5) 封装基板国产化现状
- (6) 封装基板发展趋势分析

#### 5.3.2 中国引线框架发展现状及趋势分析

- (1) 引线框架工艺概述
- (2) 引线框架技术发展分析
- (3) 引线框架发展现状分析
- (4) 引线框架竞争格局
- (5) 引线框架国产化现状
- (6) 引线框架发展趋势分析

#### 5.3.3 中国键合线发展现状及趋势分析

- (1) 键合线工艺概述
- (2) 键合线技术发展分析
- (3) 键合线市场规模分析
- (4) 键合线竞争格局
- (5) 键合线国产化现状
- (6) 键合线发展趋势分析

#### 5.3.4 中国塑封料发展现状及趋势分析

- (1) 塑封料工艺概述
- (2) 塑封料技术发展分析
- (3) 塑封料市场规模分析
- (4) 塑封料竞争格局
- (5) 塑封料国产化现状
- (6) 塑封料发展趋势分析

#### 5.3.5 中国陶瓷封装材料发展现状及趋势分析

- (1) 陶瓷封装材料工艺概述
- (2) 陶瓷封装材料技术发展分析
- (3) 陶瓷封装材料市场规模分析
- (4) 陶瓷封装材料竞争格局

(5) 陶瓷封装材料国产化现状

(6) 陶瓷封装材料发展趋势分析

## 第6章：中国半导体材料行业领先企业生产经营分析

### 6.1 半导体材料行业代表企业概况

#### 6.1.1 行业代表企业概况分析

#### 6.1.2 代表企业半导体各细分产品布局情况

#### 6.1.3 代表企业营收、毛利率等对比

### 6.2 半导体材料行业代表性企业案例分析

#### 6.2.1 天津中环半导体股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业经营状况分析

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业半导体材料业务布局

(5) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态

(6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

#### 6.2.2 上海硅产业集团股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业经营状况分析

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业半导体材料业务布局

(5) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态

(6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

#### 6.2.3 浙江金瑞泓科技股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业经营状况分析

(3) 企业业务结构及销售网络

(4) 企业半导体材料业务布局

(5) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态

(6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

#### 6.2.4 有研新材料股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体材料业务布局
- (5) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

#### 6.2.5 福建阿石创新材料股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体材料业务布局
- (5) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

#### 6.2.6 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体材料业务布局
- (5) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

#### 6.2.7 湖北鼎龙控股股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体材料业务布局
- (5) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

#### 6.2.8 安集微电子科技（上海）股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体材料战略布局及最新发展动态
- (5) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

#### 6.2.9 江苏雅克科技股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业销售渠道与网络分析
- (5) 企业经营状况优劣势分析

#### 6.2.10 苏州金宏气体股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构及新产品动向
- (4) 公司气体供应模式分析
- (5) 企业销售渠道和网络分析
- (6) 企业经营状况优劣势分析

#### 6.2.11 广东华特气体股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 公司研发能力分析
- (4) 企业产品结构及新产品动向
- (5) 企业气体供应模式分析
- (6) 企业销售渠道与网络分析
- (7) 企业经营状况优劣势分析

#### 6.2.12 广东光华科技股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业集成电路用电子化学品业务分析
- (5) 企业市场渠道与网络
- (6) 企业发展优劣势分析
- (7) 企业最新发展动向分析

#### 6.2.13 江阴江化微电子材料股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业电子化学品业务分析
- (5) 企业市场渠道与网络
- (6) 企业发展优劣势分析

#### 6.2.14 江苏南大光电材料股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业市场渠道与网络
- (5) 企业发展优劣势分析

#### 6.2.15 宁波江丰电子材料股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业靶材产品结构
- (5) 企业半导体材料战略布局
- (6) 企业发展半导体材料业务的优劣势分析

#### 6.2.16 台湾欣兴电子股份有限公司

- (1) 企业基本情况
- (2) 企业经营情况
- (3) 企业半导体材料业务布局
- (4) 企业在大陆投资布局情况

### 第7章：中国半导体材料行业市场及投资策略建议

#### 7.1 中国半导体材料行业市场

- 7.1.1 半导体材料行业生命周期判断
- 7.1.2 半导体材料行业发展潜力评估
- 7.1.3 半导体材料行业前景预测

#### 7.2 中国半导体材料行业投资特性

- 7.2.1 行业进入壁垒分析
- 7.2.2 行业退出壁垒分析
- 7.2.3 行业投资风险预警

- 7.3 中国半导体材料行业投资价值与投资机会
  - 7.3.1 行业投资价值评估
  - 7.3.2 行业投资机会分析
- 7.4 中国半导体材料行业投资策略与可持续发展建议
  - 7.4.1 行业投资策略与建议
  - 7.4.2 行业可持续发展建议

## 图表目录

- 图表1：半导体前端制造材料分类及主要用途
- 图表2：半导体后端封装材料分类及主要用途
- 图表3：半导体材料行业所属的国民经济分类
- 图表4：报告的研究方法及数据来源说明
- 图表5：中国半导体材料行业监管体制
- 图表6：截止到2021年9月8日中国半导体材料标准
- 图表7：截至2021年半导体材料行业发展主要政策汇总
- 图表8：《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》政策解读
- 图表9：《国家集成电路产业发展推进纲要》政策解读与规划
- 图表10：中国主要省市半导体产业发展规划
- 图表11：“十四五”期间地方层面半导体产业规划
- 图表12：2015-2021年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）
- 图表13：2015-2021年全国固定资产投资（不含农户）增长速度（单位：万亿元，%）
- 图表14：2015-2021年中国同比工业增加值增速（单位：%）
- 图表15：2021年中国GDP的各机构预测（单位：%）
- 图表16：2021年中国综合展望
- 图表17：中国大基金一期半导体材料投资标的（单位：亿元，%）
- 图表18：中国大基金二期半导体材料投资标的（单位：亿元，亿美元，%）
- 图表19：2019-2021年中国半导体行业并购交易案汇总（单位：百万美元，亿人民币）
- 图表20：2016-2021年中国半导体材料行业投融资事件情况分析（单位：件，亿元）
- 图表21：2021-2021年中国半导体行业前十大融资事件汇总（以金额排序）（单位：亿元）
- 图表22：半导体行业技术迭代历程
- 图表23：2015-2021年硅片相关发明专利申请数量变化图（单位：项）
- 图表24：2015-2021年硅片相关发明专利授权数量变化图（单位：项）

图表25：截至2021年硅片相关发明专利申请人构成图（单位：项，%）

图表26：截至2021年硅片相关发明专利分布领域（单位：项）

图表27：截止到2021年电子特气相关发明专利申请数量变化图（单位：项）

图表28：截止到2021年9月电子特气相关发明专利授权数量变化图（单位：项）

图表29：截至2021年电子特气相关发明专利申请人构成图（单位：项，%）

图表30：截至2021年电子特气相关发明专利分布领域（单位：项）

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202407/464319.html>